

Judul:

Pelindian Logam Dasar Tembaga Dari Sim-Card pada Media Pelarut Deep Eutectic Solvents (ChCl : Glicerol dan ChCl : Urea) Dengan Variasi Konsentrasi 1:2; 1:3; 1:4 = Leaching of Base Metal Copper from Sim-Card with Deep Eutectic Solvent (ChCl : Glicerol and ChCl : Urea) with Variation of Concentration 1:2; 1:3; 1:4

Pengarang/Penulis:

Ignatius Aditya Denta Ariawan, author

Subjek:

Electronic waste; Iodine; Electronic devices--Materials

Nomor Panggil:

S-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)